

Emploi : Ingénieur.e en développement packaging de solutions d'imagerie

Secteur : Semi-conducteur

Type de poste et catégorie : CDI - Statut cadre

Lieu : Poste basé à Moirans (38 - Isère)



L'ENTREPRISE ET SON PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Tu as envie de t'investir au sein d'une entreprise à taille humaine, dynamique et en croissance ? Notre orientation stratégique est alignée avec les valeurs que nous portons centrées sur l'Humain et la Planète : **l'Originalité**, le **Bien-vivre**, **l'Authenticité** et la **Responsabilité**.

Pyxalis est implantée depuis 2010 au cœur de la région grenobloise, terre d'excellence et d'innovation. Société indépendante de 45 personnes, nous sommes spécialisés dans le développement et la vente de capteurs d'images innovants et de solutions associées.

Au plus proche de nos clients, nous focalisons notre action sur 3 piliers marché principaux : la **santé**, la **sécurité** et **l'environnement**. Notre offre est à la fois composée de produits sur-mesure et d'autres disponibles sur étagère.

Nous recherchons un.e **Ingénieur.e en développement packaging de solutions d'imagerie** pour soutenir notre croissance et augmenter notre capacité à développer de nouveaux capteurs et systèmes.

Le processus de recrutement d'un.e Pyxalien.ne est le suivant :

- Entretien de pré qualification technique avec le manager
- Mise en situation, rencontre des équipes, visite des locaux, entretien avec le service RH
- Mon profil coopératif : Je découvre les dimensions que je mobilise pour coopérer au sein d'une équipe

N'attends plus et rejoins nous !



LES PLUS CHEZ PYXALIS

Les petits plus qui font la différence...

- Le télétravail est possible 2 jours/semaine,
- Nous proposons des berceaux en crèche,
- Nous avons créé GreenPyx, un groupe de salariés Pyxalis qui travaille sur notre macro environnement. Le but ? Réagir et agir pour limiter la crise climatique,
- Le sport, et plus largement tout ce qui participe au bien-être, est favorisé,
- Nous avons mis en place le Forfait Mobilité Durable pour encourager les trajets doux,
- Nous favorisons la formation des collaborateurs,
- Ouverture du capital à l'actionnariat salarié, intéressement, titres restaurant, chèques vacances.



ROLE & MISSIONS PRINCIPALES

Au sein d'une organisation à modèle fabless, tu seras garant.e de la recherche et du développement de solutions d'encapsulation pour des capteurs d'image très variés adressant différents types de marchés exigeants, tel que le spatial. Le poste s'inscrit aussi dans une démarche d'innovation technologique autour de nouveaux concepts de packaging avancé (interconnexions haute vitesse, architectures chiplet...). A ce titre, tes missions principales seront les suivantes :

- **Conception et gestion de projet**
 - Concevoir et développer des solutions d'encapsulation répondant aux exigences mécaniques, thermiques, électriques, à partir de la spécification de besoin du produit, (technique – environnementale - fiabilité – économiques).
 - Intégrer des considérations RF dans la conception quand cela est nécessaire : compatibilité SLVS, intégrité de signal, minimisation du bruit et optimisation des interconnexions haute vitesse.
 - Piloter le cycle de développement du packaging : spécification, conception, validation, industrialisation et qualification.
 - Assurer le suivi des sous-traitants et partenaires (contexte fabless) en garantissant la conformité produit et le respect des délais (rédaction des SOW et suivi)
- **Coordination et coopération**
 - Contribuer aux appels d'offres (RFI/ RFQ) en proposant des solutions packaging ajustées aux besoins

- Coopérer avec l'ingénieur produit en charge du suivi de production d'assemblage en lui apportant le soutien technique nécessaire à la réalisation des audits techniques, traitements des aléas techniques (hold), identifications des axes techniques de réduction de coût de fabrication, analyses et traitements des PCN, NC, 8D

- **Amélioration continue et veille technologique**

- Proposer et valider de nouvelles approches technologiques (matériaux, substrats, interposeurs, chiplet, 3D stacking, etc.) quand cela est nécessaire
- Contribuer à la roadmap d'innovation et au transfert des technologies vers la production série
- Assurer une veille technologique proactive sur l'assemblage de capteurs d'images afin de proposer des solutions innovantes et à la pointe du secteur
- Garantir en interne la connaissance de l'offre technique des fournisseurs
- Contribuer au développement du savoir-faire de la société dans le domaine du packaging



PROFIL RECHERCHÉ

Pour t'intégrer au sein de la team Pyxalis, il te faudra :

- un esprit d'innovation, de rigueur, d'analyse et de synthèse,
- une hauteur de vue et une proactivité,
- un désir de satisfaire les clients,
- une adhésion forte aux valeurs Pyxalis et à la tenue des engagements,
- une envie de travailler dans une structure à taille humaine où la coopération est clé.

Tu devras être en mesure de prendre des décisions techniques en toute autonomie dans le respect du contour projet (coût, planning, risque) et des règles de développement et de favoriser la capacité de réutilisation.





FORMATION ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

De formation ingénieur.e ou bac + 5 en microélectronique/matériaux/RF/physique appliquée... et doté.e d'une expérience d'au moins 5 ans dans le développement de packaging de composants électroniques (de préférence dans le domaine de l'imagerie), tu devras avoir une bonne maîtrise des aspects suivants :

- Négociation, communication externe et interne
- Conception de packages RF/ haute vitesse (SLVS, LVDS, intégrité de signal)
- Simulation thermique, mécanique et électrique (Ansys, HFSS, COMSOL)
- Technologies d'assemblage : wire bonding, flip-chip, underfill, interposeurs, BGA, chiplet
- Développement et industrialisation de filières technologiques d'assemblage
- Connaissance pratique des outils qualité (MSP, plans d'expériences, AMDEC, etc.)
- Anglais courant à l'écrit comme à l'oral.

